

# PA-1181-28D SPECIAL ASSEMBLING INSTRUCTION

SAI Rev: A

一. 安規要求:		Figure	膠類料號	版本
1-1	T050上方銅箔 a.上下2側不超過FRPP,不可貼到黑色FRPP b.銅箔中央凸片,需在T050上方不可超出T050	F3		
1-2	點膠需確實與點膠照片相符	F1/F2		
二. 客戶要求:		Figure	膠類料號	版本
2-1				
三. 設計性要求:		Figure	膠類料號	版本
3-1	T050, L010, C051, 所有手插零件不可浮件(浮件高度0.3mm Max.), 不可歪斜 (角度正負5度) 須和 PCB 緊貼, 在過錫爐時必要時要以治具固定			
3-2	L010/T050/L050插件前絲印框內點膠, 使零件與PCB相連		738351(ES-2031W)	
3-3	插件前先用治具將晶體(D050、Q010、D003、Q050、Q050-1、Q200、Q250) 固定於夾片或鎖附螺絲與散熱片上。			
3-4	D050與HS1 間, Q010、D003、Q050、Q050-1與HS3 間, 需點散熱膏(734059)。 D050、Q001、Q050、Q051背面散熱膏用量0.01g(Min.)與覆蓋率要達到90%以上並用檢驗試片進行確		734059	
3-5	認。 Q200、Q250與HS2之間, 需點散熱膏(734059)。 Q200、Q250背面散熱膏用量0.01g(Min.)與覆蓋率要達到90%以上並用檢驗試片進行確認。		734059	
3-6	D050需用螺絲鎖附與HS1固定。 Q010、D003、Q050、Q050-1需用螺絲鎖附與HS3固定後過錫爐。 Q200、Q250需鎖附螺絲與HS2固定後過錫爐。			
3-7	FRPP組裝時須將定位片裝入後, 再裝下鋁套, J3、J4 魚叉PIN焊接後不可造成下鋁套 浮件。			
3-8	所有零件面點膠需與照片符合, 焊錫面(SMD面)點膠, 膠量要求均勻並符合MOI要求。	F1/F2	738351(ES-2031W)	
3-9	Q010、D003、Q050、Q050-1、C001、L010、C051與HS3之間點膠(位置在HS3內)	F1	738351(ES-2031W)	
3-10	L001與HS3之間需點散熱膠相連。	F1	738351(ES-2031W)	
3-11	L001與上方鋁套之間需點散熱膠相連。	F1	738351(ES-2031W)	
3-12	L002側面點膠, L002側面與C001之間點膠相連, L010側面與C002/L003之點膠相連	F1	738351(ES-2031W)	
3-13	D050與HS1之間點膠, L003與HS1之間點膠	F1	738351(ES-2031W)	
3-14	HS1轉角處與C060之間點膠相連	F1	738351(ES-2031W)	
3-15	L050、T050之間點膠, L050側面點膠, T050與HS1之間點膠	F1	738351(ES-2031W)	
3-16	T050上方需點膠, 膠不超過銅箔, 以免影響銅箔貼合	F1	738351(ES-2031W)	
3-17	裝入飛線FG1/FG2 (P/N:830411) 走L002與L010之間,走D003與L010之間, 經過Q050-1與HS1之間,走Q200與T050之間			
3-18	貼銅箔(P/N: 8A0148)於L010上方銅箔和HS3下鋁套(鋁套側面有缺口)相連, 貼銅箔(P/N: 8A0149)於下鋁套和 HS1/T050上方銅箔和HS3與下鋁套(鋁套側面有缺口)相連 EE要求,此兩銅箔貼完後需要有壓痕			
四. 其他要求:		Figure	膠類料號	
4-1	焊錫面限高2.5mm, 一般腳長不得大於2.5mm。 J3&J4焊後,錫點不可高於下鋁套			
4-2	DC cord 焊後出腳不得超過2.5mm			
4-3	鋁套組裝後, 下鋁套凸點部份要確實折入上鋁套之凹槽內以確保機芯高度。			
4-4	鋁套組裝後, 機芯高度要介於24.6+/-0.3mm, 上鋁套不可張開, 整體寬度不可大於71mm。			
4-5	組裝外殼時, 下蓋先裝入,確定PCB和Shielding-BTM整個被完全卡入; 且INLET和DC CORD也需裝入卡樁內, 先卡下CASE再卡上CASE。			
4-6	上下蓋合後: 需鎖附4個螺絲和4個Rubber Foot.(螺絲扭力定義8+/-1kgf, MOI內需定義) 上下蓋鎖附螺絲後: 中縫規格0.6+/-0.3mm.(Follow 客戶外觀尺寸要求)			
4-7	機台所有點膠量要控制在規定重量(零件面Min29.8g, 錫面Min 9.6g)並符合MOI之要求			
4-9	組裝後INLET FG PIN 需在上方(無螺絲孔面)請勿裝反。			
4-10	INLET 與 CASE 鉚合後(上,下,左,右)間隙不可大於0.3mm			

ME:

EE:

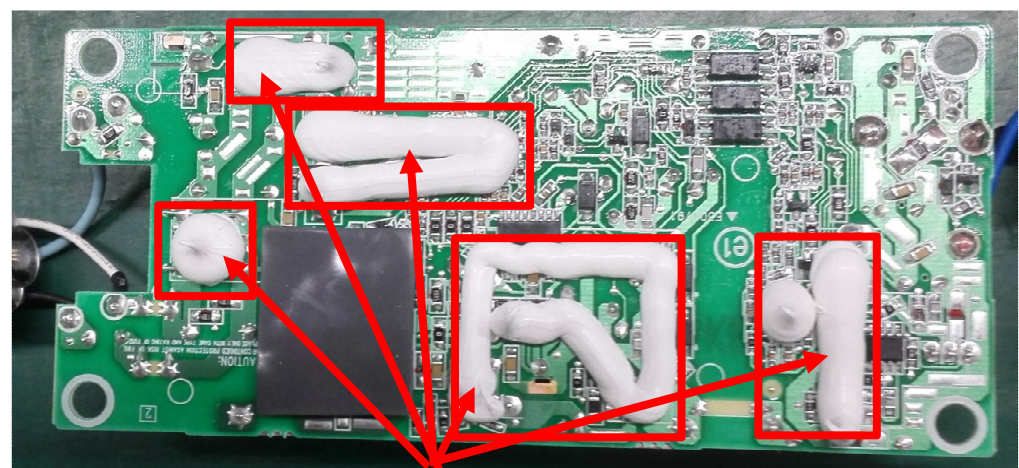
ME LEADER:

F1



此處過爐後點膠

F2



此處過爐後點膠, 膠需覆蓋D050/Q050/Q050-1 and T050 PIN腳 /Q200 PIN

F3



L010上方銅箔需連接至HS3和下鋁套

T050上方銅箔需連接至HS1/HS3和下鋁套

安規要求:  
T050上方銅箔  
a. 上下2側不超過FRPP, 不可貼到黑色FRPP  
b. 銅箔中央凸片, 需在T050上方不可超出T050

EE要求, 此兩銅箔貼完後需要有壓痕